

HIGH PERFORMANCE SENSORIK

1. Statusworkshop des BMBF-Wachstums-kerns HIPS

19. März 2020, 09:00 – 17:00 Uhr
Hotel Tanne, Ilmenau/Thüringen

 *Powered by SiCer – The best of both worlds*

Im **Wachstums-kern HIPS** arbeiten 12 Thüringer Industrieunternehmen und 7 Forschungseinrichtungen gemeinsam daran, die bereits patentierte SiCer-Technologie, einer einzigartigen Verbindung von Silizium-technologie (Si) mit keramischer Mehrlagentechnik (Cer), zur Anwendungsreife zu bringen. Gemeinsames Ziel der hauptsächlich im Technologiedreieck Ilmenau – Erfurt – Jena/Hermsdorf des Sensorlandes Thüringen angesiedelten Partner ist es, basierend auf der SiCer-Technologie neue Hochleistungssensoren zu entwickeln und perspektivisch gemeinsam zu vermarkten.

Im Rahmen dieser vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Veranstaltung soll neben dem Überblick über die Schwerpunkte des Wachstums-kern auch der Stand der Forschung und Technik zur Hochleistungssensorik, der Mehrlagenkeramiktechnologie und der Si-basierten Verbindungstechnik gegeben werden.

www.sicer.de

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

IMAPS Frühjahrskonferenz 2020

18. März 2020 | 09:00 Uhr – 16:30 Uhr | TU Ilmenau, Audimax, Humboldt-bau, Ilmenau/Thüringen

Wie gewohnt referieren hochkarätige Experten aus Industrie und Forschung unter dem Titel „**MikroSystemIntegration – grenzenlose Vielfalt!**“ zu den aktuellen Themen der Aufbau- und Verbindungstechnik. Eine Führung durch die Labore der Universität rundet die Veranstaltung ab.

www.imaps.de



Workshop Aufbau- und Verbindungstechnik der Forschungslabore Mikroelektronik Deutschland (ForLab)

20. März 2020, 09:00 Uhr – 16:00 Uhr | TU Ilmenau, Hu 201, Humboldt-bau, Ilmenau/Thüringen

Ziel des Workshops ist die Kompetenzerfassung und die Vernetzung der **ForLabs**, die wesentliche Forschungsschwerpunkte in der mikroelektronischen Aufbau- und Verbindungstechnik haben und diese ausbauen. Darüber hinaus soll auch die Brücke zur **Forschungsfabrik Mikroelektronik** gespannt werden. www.tu-ilmenau.de/nsme/forlab-nsme



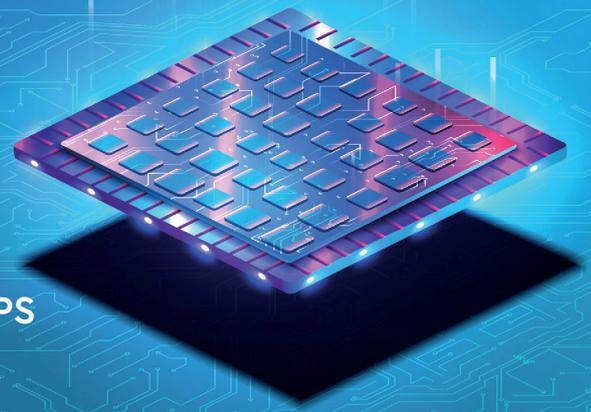
GEFÖRDERT VOM



[Anmeldung und weitere Infos unter www.sicer.de](http://www.sicer.de)

HIGH PERFORMANCE SENSORIK

1. Statusworkshop des BMBF-Wachstumskeims HIPS



PROGRAMM

GEFÖRDERT VOM



09:00	Eröffnung und Grußworte	Jens Müller	TU Ilmenau
09:30	Entwicklungstrends der Sensorik	Peter Krause	AMA
10:00	Glasses and glass ceramics in electronic and sensor applications	Martin Letz	Schott
10:30 Kaffeepause			
11:00	Technologien zur Realisierung und Integration von MEMS-Komponenten	Roy Knechtel	HS Schmalkalden
11:30	MEMS-Sensorik aktuelle Entwicklungen am CiS	Andrea Cyriax	CiS Erfurt
11:55	Elektrostatischer Mikrotaster als multifunktionales Messsystem	Boris Goj	5microns GmbH
12:20	MEMS-basierte IR-Komponenten	Karl-Heinz Suphan	CMOS-IR
12:45 Mittagspause			
13:30	Serienfertigung von Silicon to Ceramic Assemblies für Automotive-Drucksensoren	Markus Eberstein	EPCOS-TDK
14:00	Systemintegration auf 3D geformten keramischen Schaltungs-trägern für hochzuverlässige Mikrosysteme	Christian Zeilmann	MSE GmbH
14:25	LTCC-Materialien für die Verbindung mit Silizium	Clemens Motzkus	Fraunhofer IKTS
14:50	SiCer – ein innovatives Verbundsubstrat für neue Sensorlösungen (Basis für den Wachstumskeim HIPS)	Michael Fischer	TU Ilmenau
15:15 Kaffeepause			
15:45	Mit einem Quantensprung zu einer neuen Technologieplattform für Sensoren höchster Anforderungen	Franz Bechtold	Via electronic GmbH
16:10	High Performance Flüssigkeitssensoren durch SiCer	Olaf Mollenhauer	Kompass GmbH
16:35	Entwicklung multifunktionaler Gas-Sensoren höchster Zuverlässigkeit auf Basis der SiCer-Verbundsubstrat-Technologie	Klaus Ettrich	CiS Erfurt
17:00 Ende der Vorträge			
18:00	Abendveranstaltung/Networking	Separate Registrierung erforderlich	